

**Bruxelles, le 21 novembre 2018
(OR. en)**

**14559/18
ADD 1**

**ENV 797
MI 870
DELECT 153**

NOTE DE TRANSMISSION

Origine: Pour le secrétaire général de la Commission européenne,
Monsieur Jordi AYET PUIGARNAU, directeur

Date de réception: 19 novembre 2018

Destinataire: Monsieur Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secrétaire général du Conseil
de l'Union européenne

N° doc. Cion: C(2018) 7499 final - Annexe

Objet: ANNEXE de la directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins
de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de
la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne une exemption relative au plomb dans les soudures visant à
réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du
semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée

Les délégations trouveront ci-joint le document C(2018) 7499 final - Annexe.

p.j.: C(2018) 7499 final - Annexe



Bruxelles, le 16.11.2018
C(2018) 7499 final

ANNEX

ANNEXE

de la

directive déléguée de la Commission

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée

ANNEXE

À l'annexe III, l'entrée 15 est remplacée par le texte suivant:

«15	Le plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée	S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes: <ul style="list-style-type: none">– le 21 juillet 2021 pour les EEE des catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels;– le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8;– le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.
15 a)	Le plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie: <ul style="list-style-type: none">– un nœud technologique de semi-conducteur de 90 nm ou plus;– une puce unique de 300 mm² ou plus dans tout nœud technologique de semi-conducteur;– des boîtiers à puces empilées avec puce de 300 mm² ou plus, ou des interposeurs en silicium de 300 mm² ou plus.	S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021.»